

<<电子工艺实训基础>>

图书基本信息

书名：<<电子工艺实训基础>>

13位ISBN编号：9787122007889

10位ISBN编号：712200788X

出版时间：2007-8

出版时间：7-122

作者：孙蓓

页数：182

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子工艺实训基础>>

内容概要

电子技术的飞速发展不仅要求技术人员有一定的理论技术基础，还要掌握一定的电子实际操作技术以适应社会发展的需要。

电子工艺实训基础就是一门实践性很强的实训课程，通过课程学习和训练使学生掌握电子元件的检测、电子原理图分析、PCB板的设计和制作工艺、手工焊接和SMT表面贴装工艺以及各种仪器和工具的使用方法。

本书以简要的原理为基础，以典型电子产品为实例，着重介绍了电子产品的制作调试工艺。

主要内容包括：安全用电知识，常用电子元器件性能和原理，手工焊接和自动焊接工艺及表面贴装工艺，PCB板的设计和制作工艺，组装和调试工艺，电子工艺文件介绍，电子实训产品和常用的电子仪器使用方法等。

本书可作为工科大专院校相关专业的学生和职业培训教材，也可作为从事电子工艺工程技术人员的参考书。

<<电子工艺实训基础>>

书籍目录

第1章 安全用电	1.1 触电及其对人体的危害	1.1.1 触电对人体危害	1.1.2 产生触电的因素
	1.1.3 安全电压	1.2 触电原因及防护	1.2.1 触电原因
		1.2.2 防止触电	1.2.3 触电急救
1.3 设备安全用电	1.3.1 设备通电前检查	1.3.2 设备使用异常的处理	1.4 电子装焊操作安全
	1.4.1 防止机械损伤	1.4.2 防止烫伤	1.5 用电安全技术
	1.5.2 漏电保护开关	2章 常用电子元器件	2.1 电阻器
		2.1.1 电阻器和电位器的型号命名方法	2.1.2 电阻器的主要参数及标志方法
		2.1.3 电阻器的种类、结构及性能特点	2.1.4 电位器
	2.2 电容器	2.2.1 电容器的型号命名方法	2.2.2 电容器的主要参数及标志方法
	2.2.3 电容器的种类、结构及性能特点	2.2.4 可变电容器	2.3 电感器和变压器
	2.3 电感器和变压器	2.3.1 电感器的型号命名方法	2.3.2 电感器的主要参数及标志方法
	2.3.2 电感器的主要参数及标志方法	2.3.3 电感器的种类、结构及性能特点	2.3.4 变压器
	2.4 半导体分立器件	2.4.1 半导体分立器件的命名与分类	2.4.2 常用半导体器件
	2.5 集成电路	2.5.1 集成电路的种类	2.5.2 集成电路的外形封装和端子识别
	2.6 表面安装元器件	2.6.1 无源器件(SMC)	2.6.2 有源器件(SMD)
	2.7.1 电声器件	2.7.2 开关	2.7.3 继电器
	2.7.2 开关	2.7.3 继电器	3章 焊接工艺
	2.7.3 继电器	3.1 焊接基础知识	3.1.1 焊接的分类
	3.1 焊接基础知识	3.1.2 焊接的方法	3.1.3 锡焊机理
	3.1.2 焊接的方法	3.1.3 锡焊机理	3.2 焊接工具与材料
	3.1.3 锡焊机理	3.2 焊接工具与材料	3.2.1 焊接工具
	3.2 焊接工具与材料	3.2.1 焊接工具	3.2.2 焊接材料
	3.2.1 焊接工具	3.2.2 焊接材料	3.3 手工焊接工艺
	3.2.2 焊接材料	3.3 手工焊接工艺	3.3.1 焊前准备
	3.3 手工焊接工艺	3.3.1 焊前准备	3.3.2 手工焊接分类
	3.3.1 焊前准备	3.3.2 手工焊接分类	3.3.3 焊点的质量要求
	3.3.2 手工焊接分类	3.3.3 焊点的质量要求	3.3.4 焊接要领
	3.3.3 焊点的质量要求	3.3.4 焊接要领	3.3.5 焊接步骤
	3.3.4 焊接要领	3.3.5 焊接步骤	3.3.6 印制电路板的焊接
	3.3.5 焊接步骤	3.3.6 印制电路板的焊接	3.3.7 几种典型器件焊接方法
	3.3.6 印制电路板的焊接	3.3.7 几种典型器件焊接方法	3.3.8 拆焊
	3.3.7 几种典型器件焊接方法	3.3.8 拆焊	3.3.9 焊接质量检查
	3.3.8 拆焊	3.3.9 焊接质量检查	3.4 自动焊接
	3.3.9 焊接质量检查	3.4 自动焊接	3.4.1 浸焊
	3.4 自动焊接	3.4.1 浸焊	3.4.2 波峰焊
	3.4.1 浸焊	3.4.2 波峰焊	3.5 表面安装
	3.4.2 波峰焊	3.5 表面安装	3.5.1 表面安装技术特点
	3.5 表面安装	3.5.1 表面安装技术特点	3.5.2 表面安装材料
	3.5.1 表面安装技术特点	3.5.2 表面安装材料	3.5.3 表面安装工艺
	3.5.2 表面安装材料	3.5.3 表面安装工艺	3.6 无锡焊接
	3.5.3 表面安装工艺	3.6 无锡焊接	3.6.1 压接
	3.6 无锡焊接	3.6.1 压接	3.6.2 绕接
	3.6.1 压接	3.6.2 绕接
	3.6.2 绕接	第4章 印制电路板的设计与制作工艺
	第4章 印制电路板的设计与制作工艺	第5章 准备与装配工艺基础
	第4章 印制电路板的设计与制作工艺	第5章 准备与装配工艺基础	第6章 调试工艺
	第5章 准备与装配工艺基础	第6章 调试工艺	第7章 电子技术文件
	第6章 调试工艺	第7章 电子技术文件	第8章 电子实习产品
	第7章 电子技术文件	第8章 电子实习产品	第9章 常用电子仪器仪表的使用
	第8章 电子实习产品	第9章 常用电子仪器仪表的使用	参考文献

<<电子工艺实训基础>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>